

Information Meeting 2008

株式会社 村田製作所



電子機器生産台数



(単位: 百万台、%)

		2006年度	2007年度		2008年度	
				前期比		前期比
携帯電話	販売	913	1,074	+18%	1,146	+7%
	部品需要	990	1,155	+17%	1,231	+7%
PC	販売	235	271	+15%	280	+4%
	部品需要	247	276	+12%	291	+6%

電子機器の最終需要は引き続き堅調に成長

電子部品の需要数量の拡大は引き続き期待できる

携帯電話

- 第三世代端末の生産台数が2010年まで年率30%程度増加
 - *第三世代端末一台当たりの部品使用数量
 - コンデンサ: 約300個 (GSM端末の約1.5倍)
 - 表面波フィルタ: 約9~10個 (GSM端末の約3倍)
 - *W-LANやGPS、地上デジタルなどの付加機能の搭載率の上昇
- 来年以降、新興国においても普及局面から徐々に買い替え局面に進むに伴い、高機能化が進展

今後の市場環境

薄型テレビ

- 生産台数は引き続き二桁の成長率を維持
- 高画質化などの機能向上は、買い替え、買い増し需要を喚起
- 大画面化は一台当たりのコンデンサ使用数量の増加をもたらす
32インチ：約700～800個 40インチ超：1,000個以上

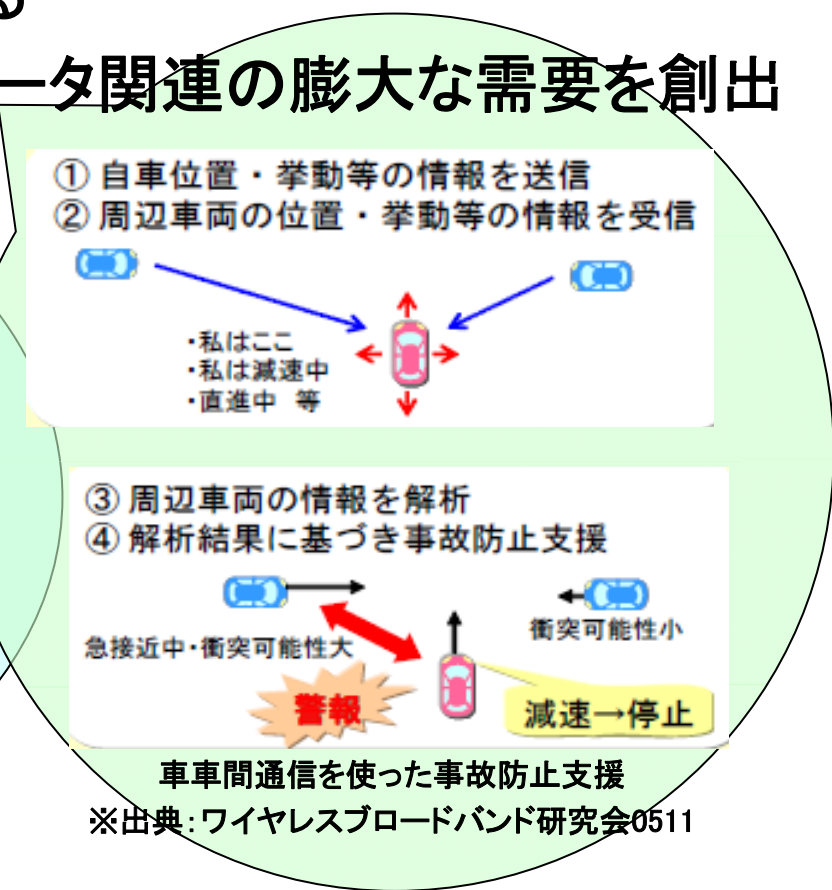
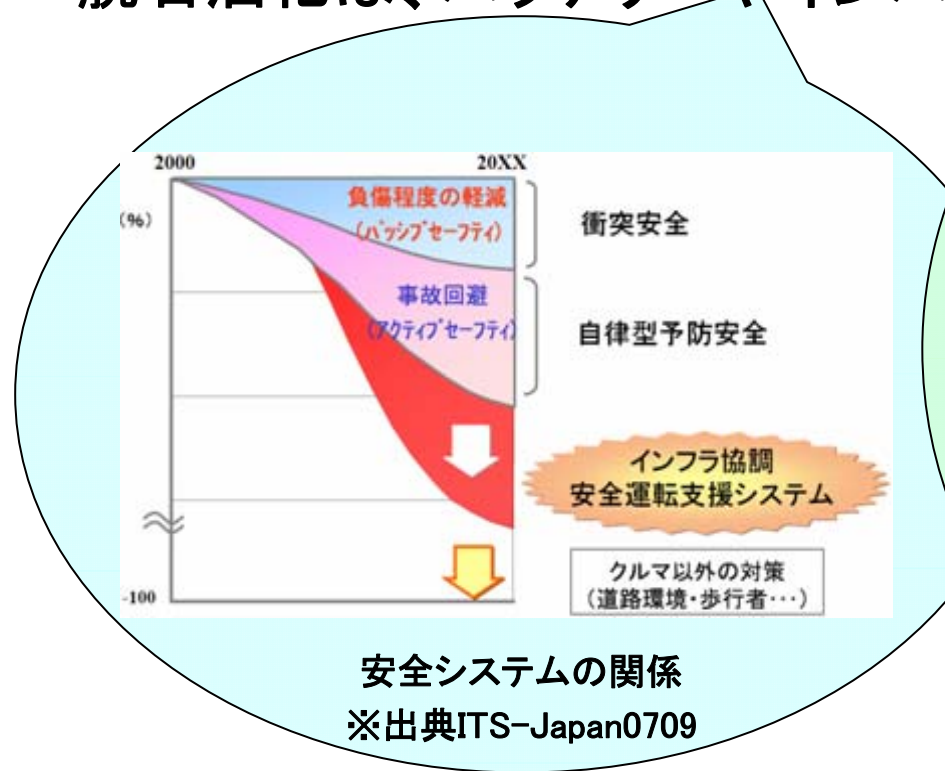
パソコン

- ノートパソコンの生産台数が堅調に推移、2010年まで年率二桁以上の増加が続く
- 更なる性能向上、無線通信機能の拡充は、部品使用数量の増加をもたらす
- 低価格ノートパソコンはパソコン生産台数の一層の拡大につながり、部品需要の増加に貢献

今後の市場環境

自動車

- 安全性、快適性の追求において急速に電子化が進んでおり、広く当社の部品需要が見込まれる
- 脱石油化は、バッテリーやインバータ関連の膨大な需要を創出



今後の市場環境

自動車



インターネット接続
※出典: スマートウェイ

コンデンサの動向、商品戦略

大容量品

■ 需要の成長継続

- *携帯電話やパソコン、薄型TVなど主要セットの生産は引き続き伸張、高機能化も引き続き期待できる
- *携帯電話における第三世代端末の構成比増や、3.9世代・第4世代といった次世代方式の登場
- *コンピュータのMPUのメニーコア化、高機能化

■ 薄層化の取り組み

- * 0.5 μm の薄層誘電体を使用した大容量品をまもなく商品化
 - 2012サイズ 100 μF
 - 1005サイズ 10 μF

コンデンサの動向、商品戦略

超小型品 (0.6×0.3ミリ品、0.4×0.2ミリ品)

- 携帯電話のパワーアンプモジュールからはじまり、最近では携帯電話本体、携帯型のメディアプレイヤーやゲーム機への搭載が進む
- 2008年度に入っても順調に需要増

用途特化型品

- 高いシェア、デュアルコア化・クアッドコア化により需要が拡大

大容量品・小型品・用途特化型品のハイエンドコンデンサ

- ◆ 当社のコンデンサ売上高の約6割を占める
- ◆ セット生産台数増加・高機能化により成長トレンド継続

ノイズ対策部品の動向、商品戦略

機器のデジタル化、高機能化に伴うノイズの拡大 による需要の高まり

- ノイズ除去効果の高いチップインダクタ(*BLM*)
- 各搭載ICの駆動電圧に合わせて変圧するチップコイル(*LCHIP*)
- デジタルAV機器の電源ラインのノイズ対策に特性を発揮するチップ3端子型コンデンサ(*NFM*)
- USB2.0やHDMIなどの高速インターフェイスで発生するノイズを効果的に除去するチップコモンモードチョークコイル(*DCC*)
- 電流重畳インダクタンス特性に優れ、DC-DCコンバータの小型・薄型化に対応できる積層タイプのパワーインダクタ

表面波フィルタの動向、商品戦略



- ここ数年の需要急増局面において、新製品投入と積極投資による供給力拡大によりシェアアップに成功
→現時点のシェアはトップシェアの40%
- 携帯電話の生産台数増加に加え、マルチバンド化に伴い1台当たりの使用数量増加
GSM端末：2～3個 → 第三世代端末：9～10個
- 境界弾性波フィルタ
 - *中空構造を不要とする新構造により大幅な小型化（面積比で従来品の約1/3）とコストダウンを実現
 - *温度・圧力に対する耐性の向上

センサ関連製品の動向、商品戦略

ショックセンサ

- HDDの衝撃検知だけでなくローテーション検知用にも使用され、1台あたりの使用数量が増加
- 2.5インチ以下のHDDでは大半に搭載3.5インチのHDDでも記録データの大容量化、高密度化により搭載率が上昇
- 自動車のエアバッグシステムやTPMSにおけるタイヤの動き検知にも使用



ショックセンサ

センサ関連製品の動向、商品戦略

超音波センサ

- 自動車のバンパーや室内に搭載され、障害物や侵入者を検知
- 自動車への搭載率が上昇している上、障害物との距離だけでなく方向も検知するべく、1台あたりの使用数量も増加

微細加工技術のMEMS

- カーナビゲーション用のMEMSジャイロなど、各種の超小型センサを開発



MEMSジャイロ

モジュール製品の動向、商品戦略

近距離無線通信モジュール

- 無線LAN モジュールの売上が急増
2008年度の売上は前期比3倍以上の見込
→近距離無線通信モジュール全体でも前期比40%程度増
- WiMAX・UWBなど次世代技術向け
モジュールもメジャーシェア獲得を
目指して開発・商品化
- Sychip社のソフトウェア技術を活用

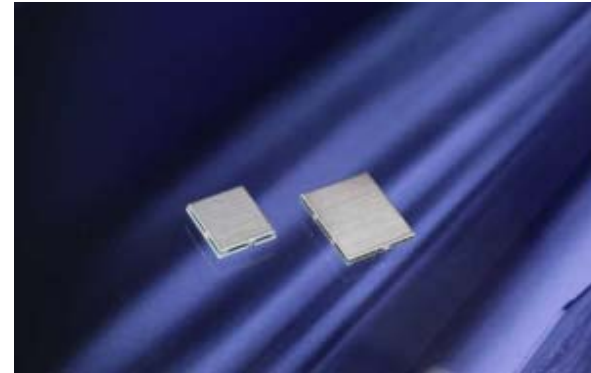


無線LANモジュール

モジュール製品の動向、商品戦略

地上デジタルチューナ

- 地上デジタルワンセグ放送用にチューナモジュールの需要
- 高画質化を目的にフルセグ対応のニーズ



地上デジタルチューナ

米国C&Dテクノロジーズ社パワー・エレクトロニクス部門買収

- 標準電源の幅広いラインナップ、海外マーケットに強み
- 当社の持つ高い省エネ技術を注入
- 今後、欧米得意先のサーバー、ルータ、基地局向けの産業用電源に本格参入

ハイブリッドコンバータ

- 車載(HEV/EV)用のハイパワーDC-DCコンバータ

2015年に売上高1兆円を目標とする長期構想

■既存事業を機軸として強化

「技術・市場のにじみだし」領域にも新製品投入

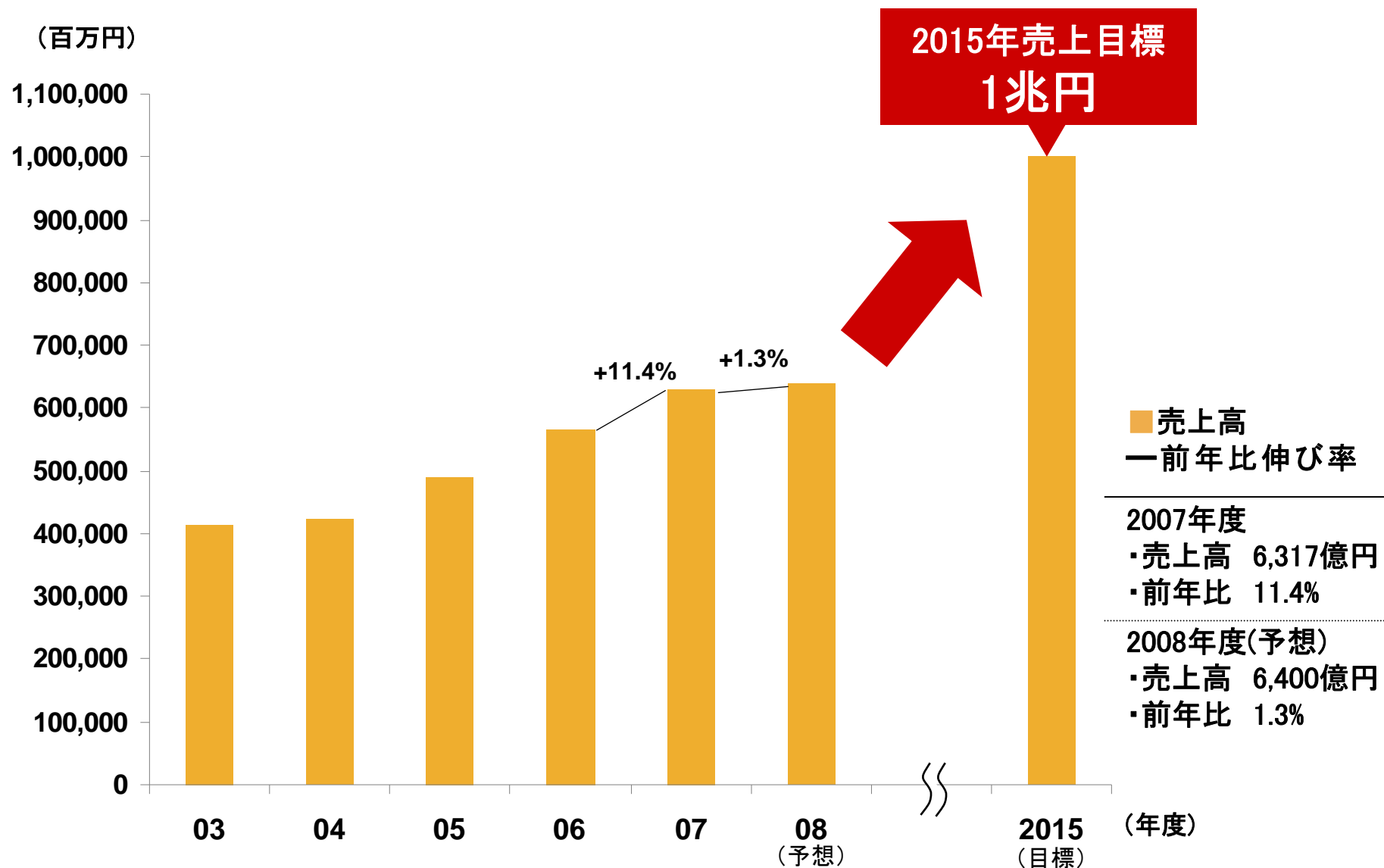
→事業領域の拡大

■新規事業の開拓

エネルギー、パワーエレクトロニクスや、バイオ、

環境市場向け電子部品に着目

長期構想

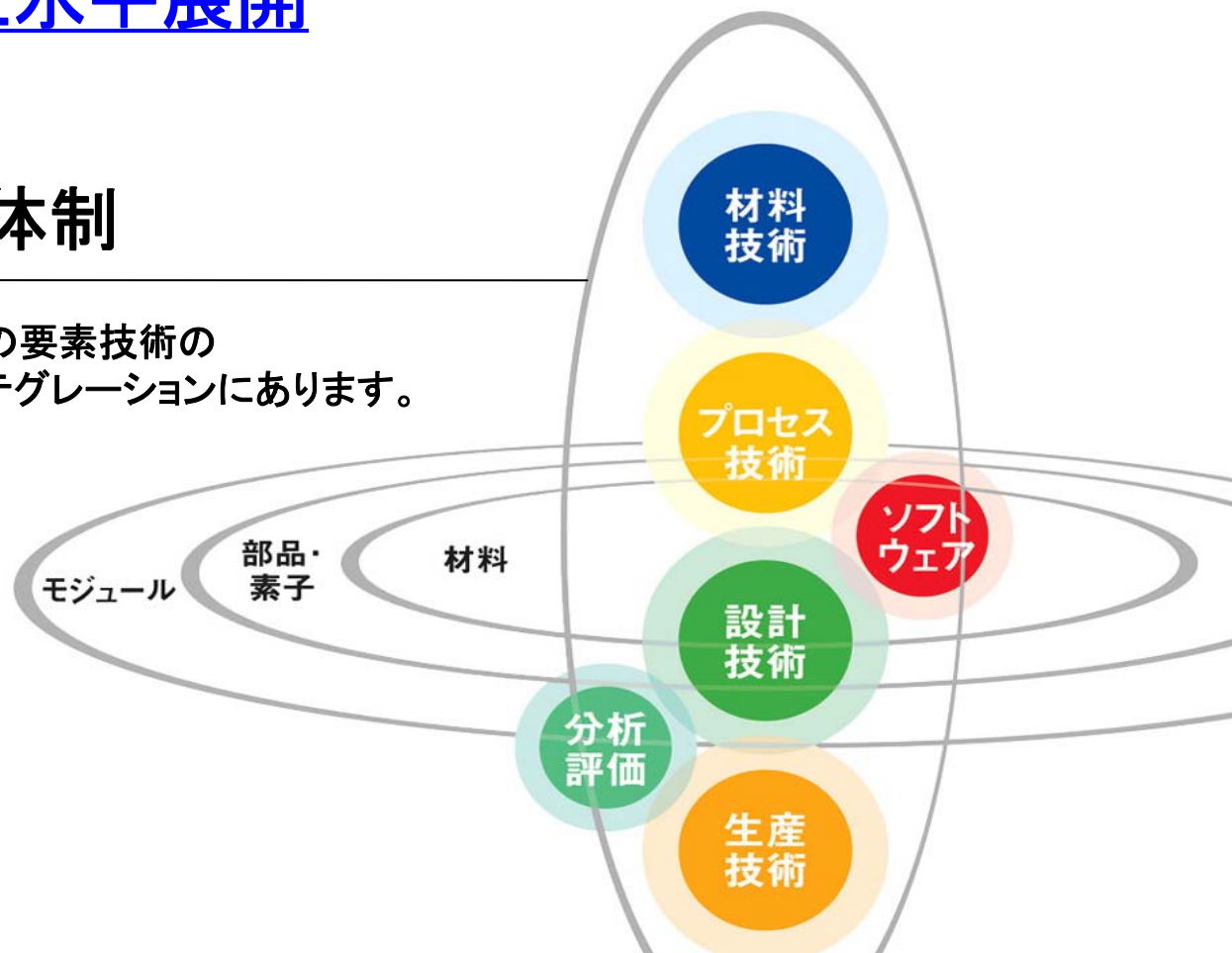


長期構想

技術の垂直統合と水平展開

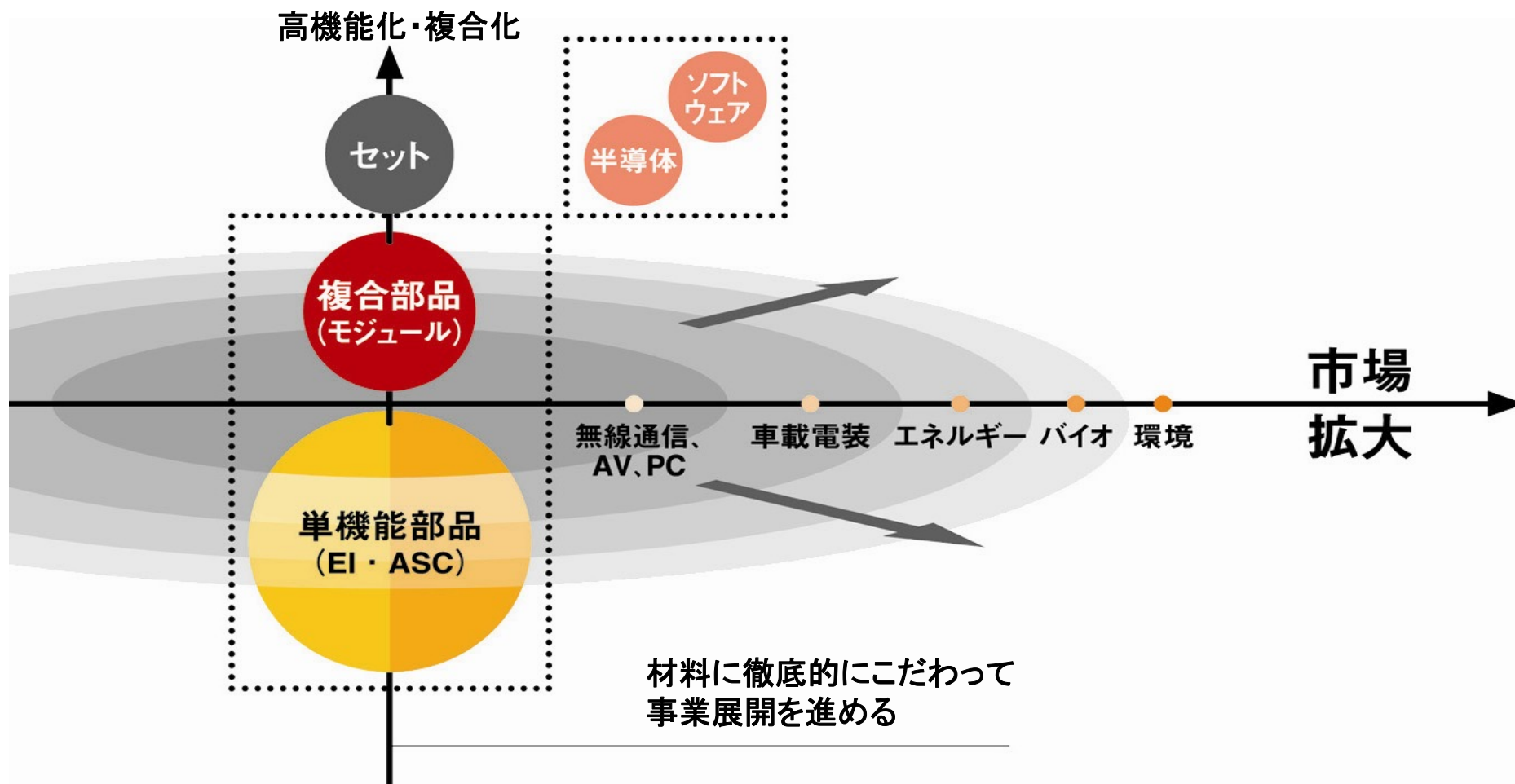
可能性を拓くR&D体制

研究開発体制の基本は、これらの要素技術の
垂直統合＝ヴァーティカル・インテグレーションにあります。



長期構想

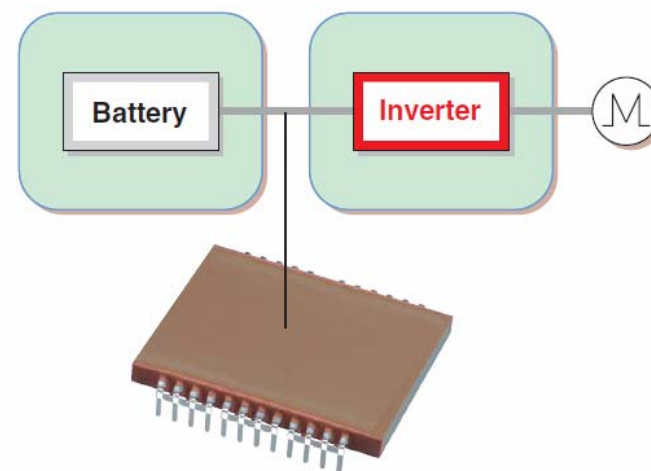
広がる事業領域



今後の事業展開

コンデンサ

- 更なる誘電体層の薄層化に取り組み、数百～1,000 μ Fレベルまで大容量化を追求する
- パワーエレクトロニクス関連での取り組み
 - *新領域となる200V超の高電圧、大電力領域におけるサージ抑制用途向けに**超大型積層セラミックコンデンサ** (40×32mm)を商品化
 - ***電気二重層コンデンサ**の開発
カメラ用のフラッシュなど、
バッテリー機器のパワーアシスト用途向け等に商品化を計画



超大型積層セラミックコンデンサ

圧電デバイス

■ 電気的特性に加え、機械的な機能も活かした用途拡大

* アクチュエータ

ディーゼルエンジンの燃料噴射装置・カメラモジュール

* 圧電スピーカー

モバイル機器向けの薄型スピーカー

* ハプティクス機能

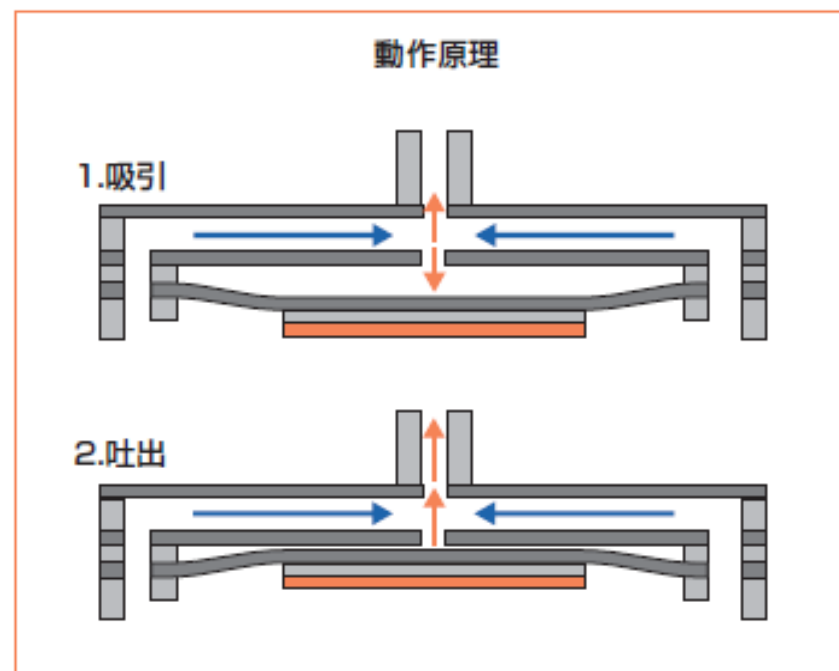
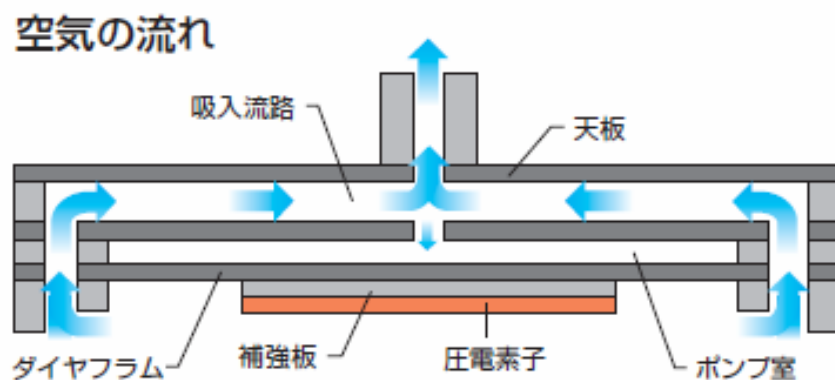
携帯機器において操作した指で振動を感じる

今後の事業展開

圧電デバイス

***圧電マイクロブロー**(送風デバイス)

超薄型(1.6mm)で無音、従来のファン型の空冷装置
と比べて消費電力を半減



今後の事業展開

センシングデバイス

- 従来のジャイロやショックセンサなどの状態検知センシングに加え、物質検知への応用も可能

*環境汚染物質の検知、またはタンパク質などの生体分子の検知などが可能

*従来のエレクトロニクス分野に加え、環境や医療・バイオといった新たな分野への応用、展開

無線通信技術

- WiMAX、UWBやLTE (Long Term Evolution)などの新しい技術への進化

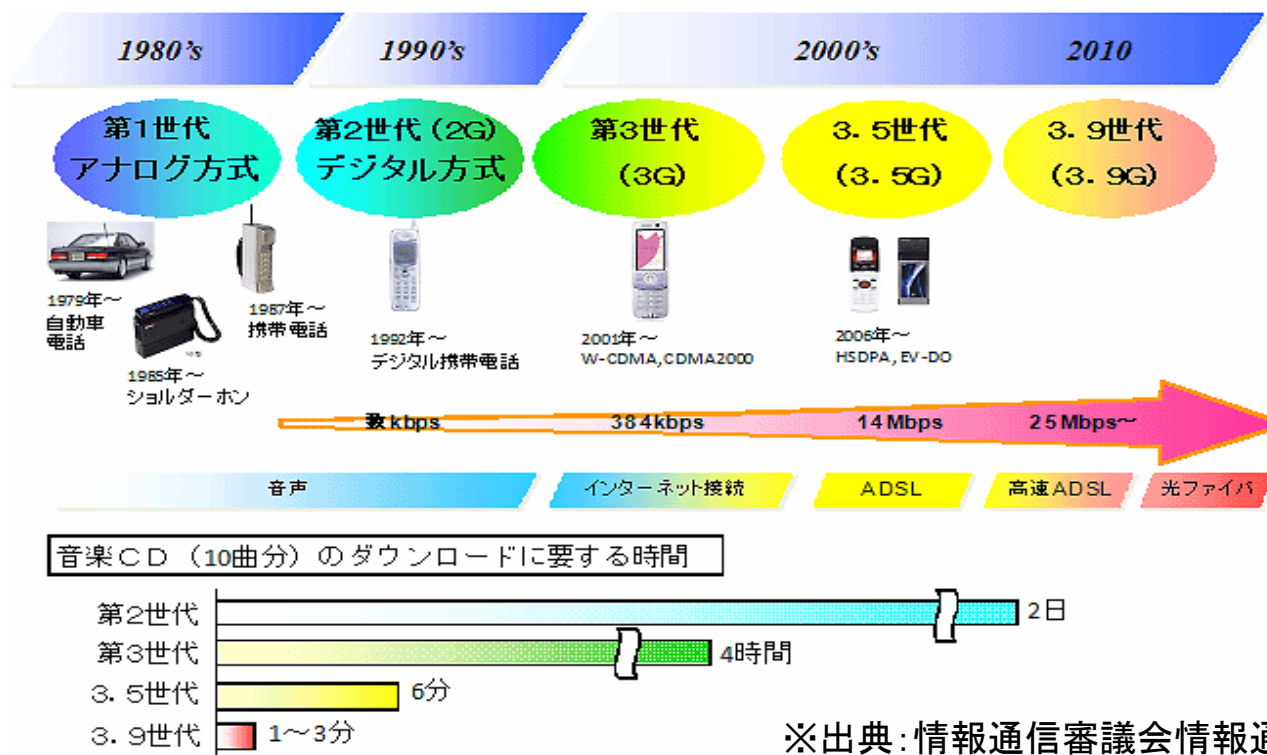
固定回線並みの通信速度を実現

- LTEが使用するMIMO (Multiple Input Multiple Output)技術では1台の端末で2系統以上の送受信回路を持つようになり、アンテナや表面波フィルタなどRF部のデバイスの使用数量が系統数や使用バンド数に応じて増加

LTE端末の生産台数予測：2015年に3～4億台

今後の事業展開

各無線通信世代の発展状況



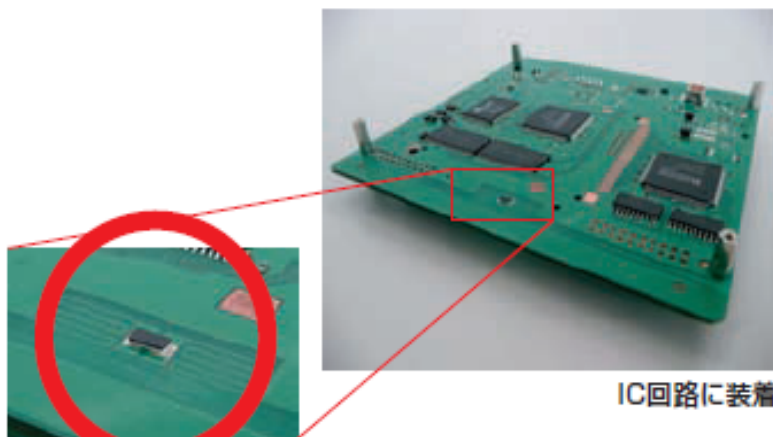
新たな部品需要増加の波をもたらす可能性

今後の事業展開

マジックストラップ®

- 電波を使った非接触の自動認識技術であるRFID (Radio Frequency Identification)用のICタグとして商品化
- マatching回路を内蔵、高熱環境においても使用可能
- 既に工程履歴管理用途で採用、梱包発送管理や入退室管理などの用途でも引き合いが増加

リフローはんだで実装可能なため、
プリント基板にRFIDタグを簡単形成



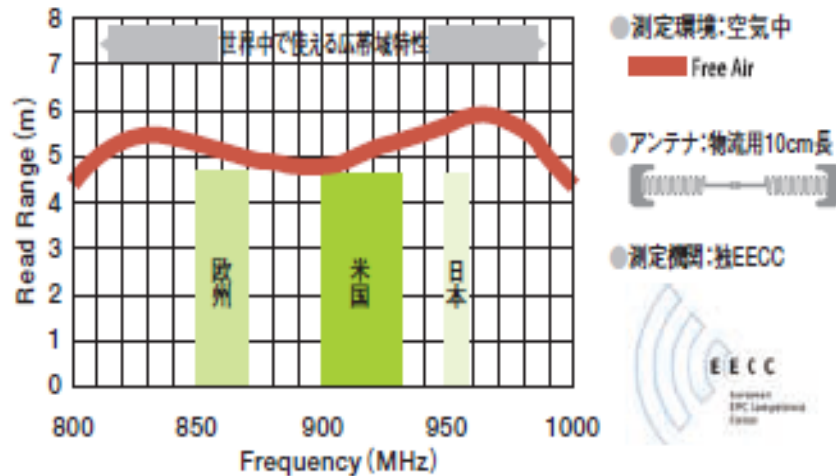
装着が難しかった対象物にも
実装可能かつ安定動作



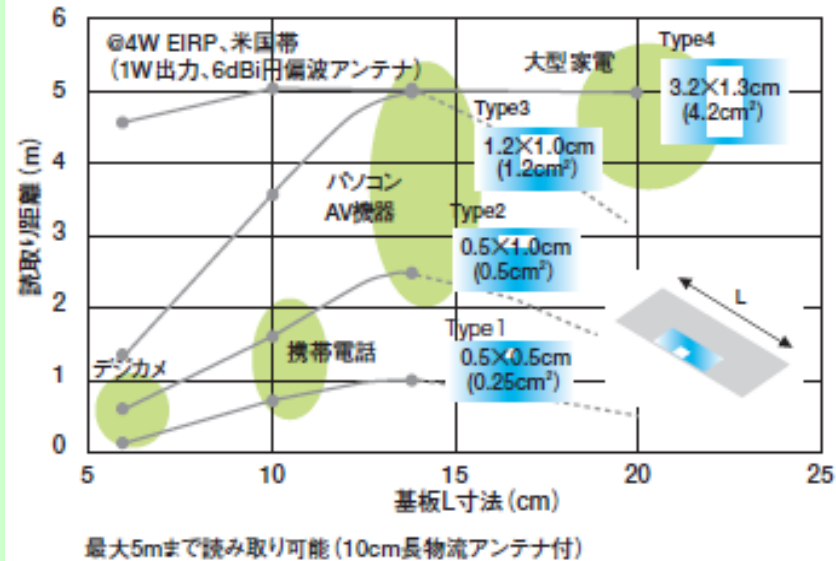
今後の事業展開

マジックストラップ®

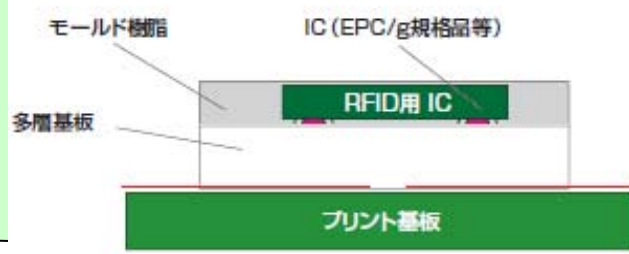
ひとつのタグデザインで世界各国で使用可能



アンテナを変えることで読み取り距離を容易にコントロール



一般の接着剤で実装可能



今後の事業展開

電池（エネルギー、パワーエレクトロニクス）

- リチウムイオン2次電池は研究開発段階
- 電池の基本技術、ノウハウを蓄積しながら、広くエネルギー関連およびパワーエレクトロニクス関連の事業化につなげる



資本政策



1株当たり配当金

(円)

	中間	期末	通期
2006年度実績	40	50	90
2007年度実績	50	50	100
2008年度計画	50	50	100

自己株式の取得

2002年～2005年：1,229億円、2,233万株取得

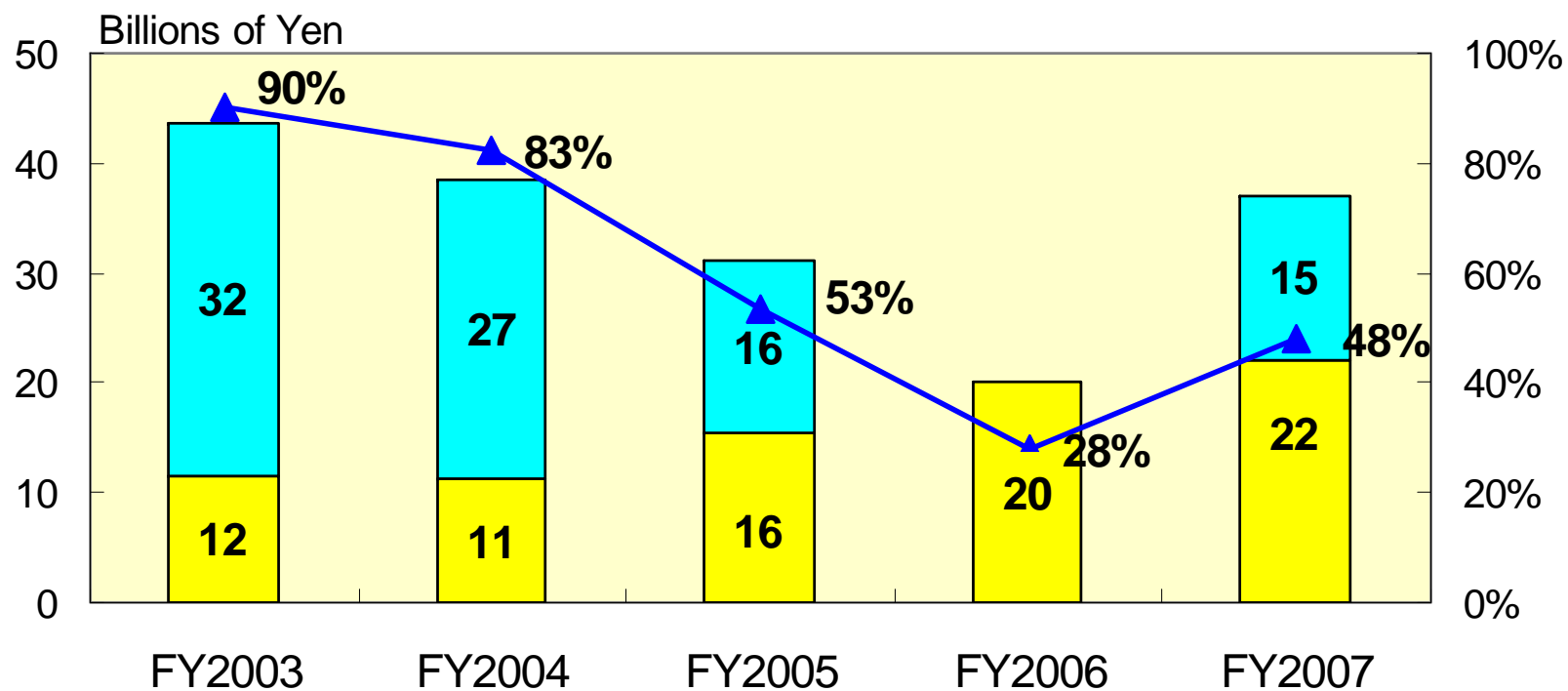
2007年度：150億円、256万株取得

※取得した自己株式は一部を除き基本的に消却

資本政策



総還元性向



当資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があります。これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1) 当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2) 原材料等の価格変動及び供給不足、(3) 為替レートの変動、(4) 変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5) 当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6) 各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7) 偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。

